****

**經濟部工業局**

**「精密機械發展推動平台暨人才扎根計畫」**

**產業人才扎根分項計畫**

**跨領域方案申請書**

**(智慧機械)**

計畫名稱：○○○○○○○○人才培育計畫

計畫執行期間：自106年1月2日至106年12月10日

計畫執行單位：○○○○學校○○○○系

**跨領域方案計畫申請表**

|  |  |
| --- | --- |
| 申請計畫名稱 |  |
| 申請領域別 | 　智慧機械 |
| 申請學校 |  | 申請科系 |  |
| 計畫主持人 |  | 職　　稱 |  |
| 學校機構印鑑 |  |
| 負責人用印 |  |

目 錄

[一、基本資料](#_Toc166665917)

[二、計畫內容](#_Toc166665919)

三、經費編列

四、附件(產學合作備忘錄)

一、基本資料

【學校基本資料表】

|  |  |
| --- | --- |
| 申請計畫名稱 |  |
| 學校名稱 |  | 科系名稱 |  |
| 學校地址 |  | 統一編號 |  |
| 計畫主持人 | 姓名 |  | 職稱 |  |
| 電話 |  | 手機 |  |
| e-mail |  | 傳真 |  |
| 協同計畫主持人 | 姓名 |  | 職稱 |  |
| 電話 |  | 手機 |  |
| e-mail |  | 傳真 |  |
| 計畫聯絡人 | 姓名 |  | 職稱 |  |
| 電話 |  | 手機 |  |
| e-mail |  | 傳真 |  |
| 專題題目 | 1. |
| 2. |
| 3. |
| 全程參與計畫人數 | 　　　　　　　　　人 | 獎學金人數 | 　　　　　　　人 |
| 學校類別 | □普通大學 □科技大學□技術學院 □其他 | 公私立別 | □國立　 □私立 |
| 產學合作企業(至少2家) | A. | 企業配合款 | A. ( 　　 )元 |
| B. | B. ( 　　 )元 |
| 企業配合款是否高於20% | □是　 □否 | 企業配合款合計 | 　　　　　　　 元 |

備註：所核定之修課人數需全程修習完成所規劃之課程，建請計畫所提之修課人數請審慎評估，若未依核定員額執行，將依契約規定辦理。

|  |
| --- |
| **參與本計畫之產學合作企業(A)** |
| 企業名稱 |  | 統一編號 |  |
| 通訊地址 |  | 聯絡人 |  |
| E-mail |  | 聯絡電話 |  |
| 營業登記證 | 編號： □無 | 工廠登記證 | 編號： □無 |
| 營業項目 |  | 預計未來聘用人數 |  人 |
| □是 □否 | 是否為獲得經濟部遴選之中堅企業。 |
| □是 □否 | 有聘用產業人才扎根計畫所培育之學生。**(若有請提供佐證文件)** |

|  |
| --- |
| **參與本計畫之產學合作企業(B)** |
| 企業名稱 |  | 統一編號 |  |
| 通訊地址 |  | 聯絡人 |  |
| E-mail |  | 聯絡電話 |  |
| 營業登記證 | 編號： □無 | 工廠登記證 | 編號： □無 |
| 營業項目 |  | 預計未來聘用人數 |  人 |
| □是 □否 | 是否為獲得經濟部遴選之中堅企業。 |
| □是 □否 | 有聘用產業人才扎根計畫所培育之學生。**(若有請提供佐證文件)** |

|  |
| --- |
| **參與本計畫之校內專任師資** |
| 姓名 | 職級 | 開課名稱 | 最高學歷 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **參與本計畫之校外師資(學界兼任或業界師資)** |
| 姓名 | 任職單位 | 職稱 | 課程名稱 | 最高學歷 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

二、計畫內容

1. 計畫目標：
2. 推動作法：
3. 計畫課程：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 計畫課程名稱 | 校內師資時數 | 校外師資時數 | 合計 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 智慧機械(跨領域)計畫課程規劃摘要說明 |
| (請敘明跨領域課程的串連性) |

備註：課程時數總計至少需達40小時

1. 專題內容：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 專題題目 |  |
| 專題研究之架構 |  |
| 實務應用面說明 |  |
| 對產業之效益說明 |  |
| 2 | 專題題目 |  |
| 專題研究之架構 |  |
| 實務應用面說明 |  |
| 對產業之效益說明 |  |
| 3 | 專題題目 |  |
| 專題研究之架構 |  |
| 實務應用面說明 |  |
| 對產業之效益說明 |  |
| 專題進度報告規劃 | (請說明專題執行期間赴企業報告之規劃，至少4次) |

1. 計畫課程及專題之連結說明
2. 獎學金發放規劃及辦法說明：

(請說明企業提供獎學金金額及學生請領獎學金之條件)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名 次 | 獎學金金額(元) | 備　註 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

備註：欄位不足填寫請自行增加

1. 就業輔導機制：

(請說明對參與計畫學生畢業後之就業規劃或協助就業機制…等。)

1. 產學合作企業對於參加本計畫學生育才及留才說明：

(請說明企業對學生提供畢業後，赴產學合作企業就業之誘因)

1. 執行成效：（請勾選填列）

□第一次參與本計畫者，填列參與計畫本年度預期產出績效

□曾參與產業人才扎根計畫，填列過去累績執行成效

(請說明預期成效、歷年執行成效、對產業貢獻、衍生產學合作...等。)

* 量化成果說明

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 編號 | 量化成果項目 | 量化值 |
| (1) | 產學合作之企業家數 | 家 |
| (2) | 學生參與本計畫之總人數 | 人 |
| (3) | 業界師資投入人數 | 人 |
| (4) | 參與本計畫學生投入相關領域人數 | 人 |
| (5) | 其他(自行增列內容) |  |

* 非量化預期效益說明
1. 計畫管理機制說明：

(請說明計畫執行期間自行管控機制)

Ex:如學生出缺勤、共同修課人數及經費動支

三、經費編列

1. 委託辦理經費表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 學校名稱 |  | 科系名稱 |  |
| 執行期間 | 106年1月2日至106年12月10日 |
| 經費項目 | 工業局經費(元) | 計算方式說明 |
| 講師費 |  |  |
| 專題指導費 |  |  |
| 國內差旅費 |  |  |
| 專家出席費 |  |  |
| 材料費 |  |  |
| 車資費 |  |  |
| 餐點費 |  |  |
| 印刷費 |  |  |
| 文具用品 |  |  |
| 保險費 |  |  |
| 雜支 |  |  |
| 合計金額 |  |  |

1. 獎學金經費表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 項次 | 提供獎學金企業名稱 | 金額(元) |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 合計金額 |  |

附件

**XXX公司暨XXX大學XX系
產學合作備忘錄**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 企業：XXXX股份有限公司 | 以下簡稱 | 甲方 |
| 學校：XX大學 XX系 | 乙方 |

茲為培養學生產業升級轉型之專業技能及就業能力，厚植技術能量扎根於校園，促進產業發展，今甲方與乙方同意共同積極推動產學合作，特定產學合作備忘錄，甲乙雙方在不影響對方正常營運及各自內部作業下，約定合作內容如下：

1. 合作方案
2. 跨領域課程方案
3. 針對跨領域人才就業所需職能，由甲方及乙方共同規劃跨領域課程。
4. 甲方同意指派講師講授跨領域之特定專業課程。
5. 乙方須負責招募學生修習跨領域之特定專業課程。
6. 專題研討方案
7. 甲方同意每年依公司需求提供跨領域專題題目及相關要求條件予乙方，乙方同意根據甲方所列要求，擇優推薦學生予甲方參加本計畫專題研究。
8. 乙方推薦學生之符合參加專題條件，需經甲方審核相關程序等決定之。
9. 推薦學生優先錄用
10. 甲方同意優先錄用經公司招募評量及面談通過之乙方參加本計畫學生。
11. 獎學金
12. 甲方同意提供新台幣 元作為乙方學生參加本計畫獎學金。
13. 獎學金發放辦法及資格由甲方及乙方共同訂定。
14. 甲乙雙方合作內容悉依本備忘錄辦理，若有未盡事宜則由雙方協議辦理。
15. 甲乙雙方應定期檢討本備忘錄下各合作方案執行成效，並依檢討結果調整次年之合作。

|  |  |
| --- | --- |
| 甲 方： 股份有限公司代表人： 職稱： 地　址： | 乙 方：XXX學校XXX科系代理人： 系主任地 址：  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 授權代表甲方用印 |  | 授權代表乙方用印 |

中華民國xxx年xx月xx日